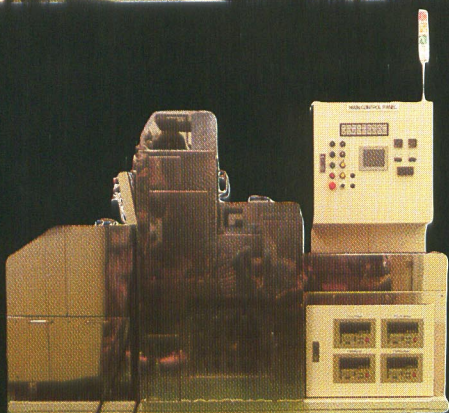
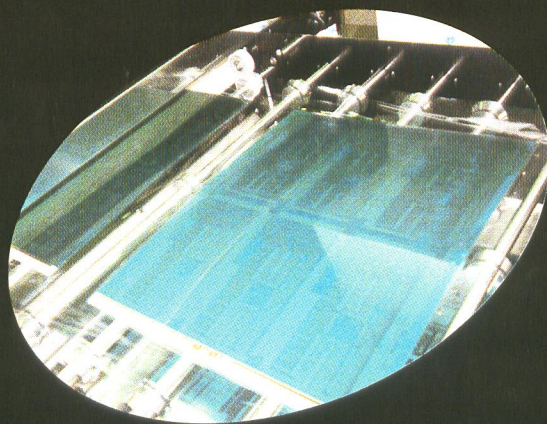
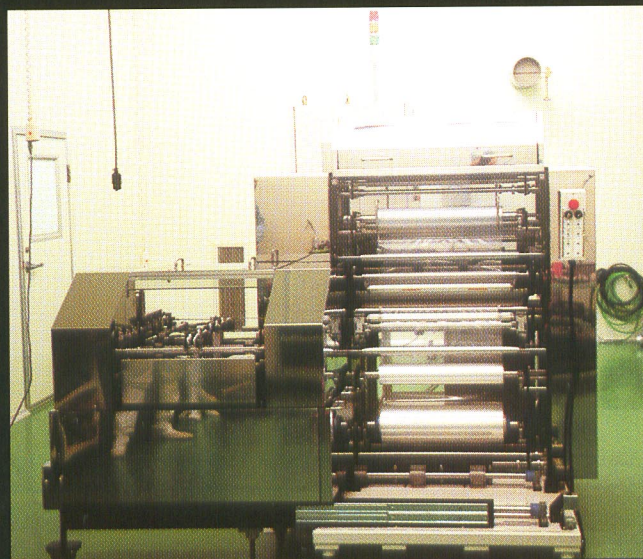


FIRST
LAMINATOR



前後工程に組み込むインライン仕様



コア材の変形による負荷を解消し基板の2枚投入を防ぐ基板クランプ挿入機構、極薄フィルムの応力による剥離を防止するための張力自動制御装置と特殊なカバーフィルム剥離機構を搭載。

VA-700ACIII

ソルダーレジスト変質防止フィルム用オートカットラミネーター

半導体パッケージ用モジュール基板のソルダーレジストは、酸素により変色変質などが発生する場合があります。

VA-700ACIII型オートカットラミネーターは、この酸素障害を防止する高透明度極薄保護フィルム専用機です。

※仕様詳細については、別途お問い合わせ下さい。



大成ラミネーター株式会社

メカトロニクス事業部

〒173-0037 東京都板橋区小茂根4丁目22番1号

TEL: 03-3958-6211 FAX: 03-3958-6421